



H6085 双组份有机硅灌封胶

H6085 双组份有机硅灌封胶是一种室温/加温固化的有机硅材料。专为防止湿气和大气污染，提供长期的密封保护而设计。尤其适用于纯度很高的产品。典型应用如：精密电子线路及混合电路的灌封和保护、小型电器的灌封，LED 的透镜灌封，IGBT 灌封等。

产品描述

常规性能

条目	部分 A	部分 B	测试标准
外观	无色透明粘稠液体	无色透明粘稠液体	目测
粘度 cps	450±100	450±100	GB/T 2794
密度 g/cm ³	0.97	0.97	GB/T 13354

产品优点

- **超低应力保护**
形成韧性凝胶，对于精密元器件在机械振动和冷热循环等恶劣环境中有很好的低应力保护。
- **耐候性**
优异的耐 UV 性能，在-40℃~180℃下性能长期保持稳定。
- **自愈合性**
在细小破坏时具有自愈合功能，可以起到更好的密封性能。
- **绝缘性能**
优异的绝缘性能，保护元器件在高压环境中正常工作。
- **环保** 无溶剂，无固化副产物。

产品操作

操作工艺

将 A.B 两组分按比例取出、搅拌混合均匀，抽真空去除气泡，在操作期内浇注到需灌封的产品上，如灌封产品太大，可分次灌封，然后根据固化条件固化即可。

条目	典型值	单位或条件
混合比例	100:100	重量比或体积比



混合粘度	450	cps
混合密度	0.97	g/cm ³
操作时间*	≥5	h
固化时间	24h	@25°C
固化时间	≤20min	@120°C

注：操作时间是以配胶量 100g 来测试的。

典型性能

性能条件

条目	测试标准	典型值	单位/备注
锥入度	GB/T269	80	1/4 锥
导热系数	GB/T 10297	0.2	W/mK
膨胀系数	GB/T 20673	410	μm/m·°C
吸水率	GB/T 8810	0.01-0.02	% (24h, 25°C)
介电强度	GB/T 1693	20	kV/mm (25°C)
损耗因素	GB/T 1693	0.01	@1MHz (25°C)
介电常数	GB/T 1693	≤3.0	@1MHz (25°C)
体积电阻	GB/T 1692	1.0×10 ¹⁵	Ω.cm (DC500V)

注：以上数据都在胶25°C、55%RH条件下固化7天后测定所得

操作注意事项

1. 取用 A、B 组分后应注意密封保存。
2. 搅拌时应注意同方向搅拌，否则会混入过多的气泡；容器边框和底部的胶料也应搅拌均匀，否则会出现由搅拌不均而引起局部不固化现象。
3. 浇注到产品上再次抽真空去除气泡，可提高固化后产品的综合性能。
4. 温度过低会导致固化速度偏慢，如有需要可加热固化。
5. 本产品与含 N、S、P 等元素的化合物以及一些重金属（Sn、Pb、Hg、Bi、As）离子化合物接触，会出现难固化或不固化的现象。
6. 本产品交联剂在 A 组分，Pt 催化剂在 B 组分。增加 A 组分可以增加硬度，一般建议的调整范围在 A:B=0.7:1 到 1.7:1 之间。

标准包装

- A 组分：18kg /桶；B 组分：18kg /桶



- 根据客户要求

产品储存及运输

A、B 组分需避光、避热、密封保存

本产品无毒性、无危险性，遵循普通化学品运输和储存。

将产品存贮于未开封的原装容器内，并存放在阴凉、干燥的区域。存储信息同时标注于产品外包装标签。

本产品最佳存储条件：25℃，保质期：9 个月

为防止未使用产品受到污染，请不要将任何材料放回原装容器。本公司不对在所述情况以外的条件下被污染或储存的产品承担责任。更具体的保存期限信息，请咨询 Hanlicon 应用工程师。

注：本文中所含的各种数据仅供参考。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。自行决定把本产品用在本文中提及的产品应用外，及未采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。本公司明确声明对所有因销售公司产品或特定场合下使用本公司产品而出现的问题，包括针对某一特殊用途的适用性问题，我们不承担责任。公司明确声明对任何必然的或意外损失都不承担责任。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。

湖南创瑾科技有限公司

中国湖南省长沙市宁乡经济技术开发区谐园北路

中国长沙智能终端产业园 5 号栋

Tel: +86-731-87827556



www.trumjin.com